

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
机构投资者调研活动记录表

编号：2024-004

| | |
|--------------------|--|
| 投资者活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议） |
| 参与单位名称 | 国海证券、国金化工、天风证券、银河证券、中银国际证券、博时基金、汇安基金、海南兴高私募基金、嘉实基金、摩根士丹利华鑫基金、银华基金、中欧基金、中金基金、华泰资管、深圳前海登程资管、上海晟盟资管、上海五聚资管、万和资管、中信资管、浙商资管、浙江观合资管、北京富智投资、广东广金投资、杭州河清投资、横琴淳臻投资、江苏瑞华投资、深圳新思哲投资、上海银叶投资、西藏合众易晟投资、中杰（厦门）投资、乘是资产、创金合信、华宝信托、景顺、深圳创富兆业、硕腾、信达澳亚 |
| 时间 | 2024年10月30日 |
| 地点 | 深圳瑞华泰 |
| 上市公司接待人姓名 | 黄泽华、柳南舟、吴臻、张政 |
| 投资者关系活动主要内容 | <p>一、2024年公司第三季度的整体经营情况介绍</p> <p>答：公司前三季度累计实现营业收入 23,914 万元，同比增长 14.7%，第三季度当季度营业收入 10,717 万元，同比增长 23.9%，环比第二季度增长 38.7%；净利润为-4,867 万元，同比增加亏损 4,100 万元，主要系受市场</p> |

竞争加剧及部分产品销售价格下降的影响。同时，嘉兴项目现处于产能爬坡阶段，单位固定成本相对较高，项目投产后利息和折旧费用化使得财务费用及管理费用同比分别增加 145% 和 27%。

经营净现金流方面，公司加强了资金风险管控，截至 9 月份的经营性净现金流为 4,185 万元，货款回笼率保持在 90% 以上，基本保持稳定水平。前三季度公司综合毛利率 18.1%，虽然同比下降 9.5 个百分点，但第三季度当季度的毛利率比上半年增加了 1.7 个百分点。费用方面，四项期间费用为 9,172 万，同比增加了 2,494 万，主要是管理费用增加 741 万元、财务费用增加 1,556 万元。

公司在调整原有产品结构的基础上，积极开拓新产品应用市场，推进客户的小批量应用评测，其中有 3 款半导体制程保护及柔性线路基材用高性能产品实现了吨量级的小批量销售，为后续进一步推动客户大批量应用奠定了基础。

二、嘉兴工厂募投项目进展情况？

答：嘉兴 1,600 吨新产能项目的厂房建设已基本完成，其中 2 条生产线已于 2023 年 9 月份投入使用，今年二季度新增 2 条生产线投入使用，目前在持续推进生产线的工艺稳定性和各公辅系统运行验证。其余 2 条化学法生产线已完成了产线与公辅设施的联调，正进行产线的工艺和产品调试，验证工艺稳定性，推动全线投料试产。

三、公司目前在电子及半导体领域产品拓展情况？

答：公司嘉兴项目目前的推进重点为电子及半导体领域产品的试制，包括小批量的量产。在电子领域，公司柔性电子基材 TPI 实现了国产化零的突破，已有小批量订单，正在逐步往下游厂商应用推广，主要应用于智能手机。

半导体领域主要是两个方向产品，一是芯片封装的 COF，一是半导体

制程使用的 PI 薄膜。从难度来讲，除了光学级的 CPI，半导体级别是 PI 薄膜的天花板。COF 需要依托国内整体产业链协同攻关，目前还没有实质性突破，但应用于半导体胶带的 PI 产品已经成功打破国外垄断，进入到下游半导体公司，应用于半导体制程，现已经接到小批量的订单，会重点推进。

四、公司三季度各产品板块的收入占比？

答：三季度营收占比较大的主要还是热控、电子和电工三大传统板块的产品。

受热控产品价格战的影响，公司主动调整产品结构，现在热控产品的收入占比降到 30% 以内；电子板块包含了新能源汽车的应用市场，现在占比已经超过一半，正在逐步放大销售份额，3 款半导体制程保护及柔性线路基材用高性能产品实现了吨量级的小批量销售，为后续进一步推动客户大批量应用奠定了基础；电工产品应用于高铁、风电绝缘电机，营收占比基本保持在 20% 左右。

五、华为推出新的三折手机，折叠屏手机市场迎来爆发，公司 CPI 何时出货量产？

答：公司在深圳建有 1 条设计产能 50 吨的 CPI 中试线,并与华为开展了折叠屏手机盖板用 CPI 薄膜的联合攻关,项目已结题并共同申请了专利。公司通过国内唯一光学级 CPI 薄膜中试平台,目前已形成较为完备 CPI 研发及工程化体系,针对折叠屏盖板、透明 FPC、柔性 LED 显示、不含氟、低成本、低轨卫星等领域开发系列产品。CPI 是 PI 材料的天花板,目前也是新型显示领域的关键基础材料。公司正在与下游共同推进光学等级 CPI 批量生产条件的优化,同时配合应用客户进行材料性能稳定性评测。因光学等级 CPI 技术要求高,评测周期长,评测成本大,公司也会适时寻求国家产业项目的支持,更快推动出货量产。

六、CPI 和 UTG 两种材料谁在折叠屏手机中的应用前景更好？

答：CPI 和 UTG 目前是折叠屏手机的两种方案，各具优势特点，并非简单的谁替代谁的关系。在小屏领域，两者都能完美适配，UTG 更能满足刚性设计要求，CPI 是透明性能最好的高分子材料。在大屏应用领域，CPI 可卷对卷生产，具有比 UTG 更大的降本空间。从行业发展趋势来讲，UTG 在无机物中做成超薄是最优选择，但是缺点易碎，如果要做成大面积的需要堆很多层保护材料，堆完后可能成本较高。未来应该是 UTG 和 CPI 的搭配使用，共同降低成本。

七、公司三季报的短期借款和应付账款均有提升，长期借款也较多，如何缓解债务方面的压力？

答：公司现阶段资产负债率基本保持在 60%左右，其中短期负债水平并不高，应付账款 1 个多亿主要是嘉兴项目刚刚投产，还有一些项目的尾款、质保金是持续在未来 2 至 3 年内支付。所以从整个短期借款的情况来看，短期负债不存在重大偿债风险。

公司的长期负债主要是嘉兴的银行贷款和可转债，可转债的存续期限是 6 年，现在还有约 4 年时间，处于转股期。因为公司近期业绩承压，股价下跌，债券持有人转股动力不足。相信随着公司整体经营质效提升，转股对债券持有人的吸引力会增加。

嘉兴银团贷款期限是 8 年，每年会有部分贷款到期偿付。公司已跟各家主要银行建立了持续稳定的合作关系，获批了足够的授信额度，可以有效保障运营的整体资金安全和稳定的业务运行。

八、公司股东层面是否有产业并购的想法？

答：聚酰亚胺材料是重资产、高技术门槛和长周期的产业，特别是在发展初期，当企业规模达不到一定程度，会承担比较重的债务压力。瑞华泰深耕这个产业 20 余年，发展过程中一直都伴随克服资金来源的问题。

从目前国家的发展战略和先进制造业的专项计划,包括深圳市 20+8 的产业政策都把聚酰亚胺材料产业列为重点发展对象,核心是提振国内的聚酰亚胺材料产业,参与全球竞争,保障国家战略基础材料的安全可控,从这个角度出发,公司也希望在国家及地方政府层面政策牵引支持下,寻求更多产业合作的机会,共同做强做优聚酰亚胺材料产业。

九、公司有没有往上游延伸布局单体的计划?

答:生产聚酰亚胺单体的供应商基本都集中在国内,对某些核心的小单体,例如高纯的单体、CPI 的特殊单体,以及半导体应用的特殊单体,因为其技术要求高,量产难度大,市场比较稀缺,公司也会重点关注。

十、公司近期转债价格持续低于 100 元,是否考虑下修转股价激发债券持有人转股,降低资产负债率?

答:公司于 2024 年 5 月 24 日召开董事会通过了暂不向下修正转股价格的决定,并且在未来 6 个月内(即 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日)再次触发下修条款的,亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 25 日起重新开始计算,若再次触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款的,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞科转债”转股价格的向下修正权利。公司将根据实际经营情况,结合市场变动、可转债转股等因素,综合考虑是否下修转股价格,并及时履行信息披露义务。

十一、公司嘉兴基地长远规划了 5,000 吨以上的产能,目前公司的现金储备不是特别多,请问公司怎样制定未来两年的资本开支计划?

答:PI 产业进入全球竞争的三个门槛为产能达到千吨级别的产能、生产线足够多,产品品种丰富、产品质量的一致性和稳定性高。公司通过近 20 年的发展,产能方面刚进入全球竞争门槛,产品质量稳定性和可靠性获得市场认可,开发了较为丰富的产品系列。公司将根据市场需求变化,及

时调整产品结构，扩大产能规模，输出新的高附加值产品，确保竞争优势。

短期来看，高频高速和轨道交通用 PI 薄膜的市场在明显扩张，公司会优先考虑相应产品布局。关于发展的资金问题，公司会通过但不限于经营现金流、银行授信借款、股权融资、引入战略投资人以及申请政府资金支持等方式统筹考虑解决，在不影响公司正常经营前提下稳步推进。

十二、公司产品在宇航太空场景有哪些应用，中国版星链计划是否带来较大增量市场？

答：美国杜邦公司在上世纪 60 年代为应对航天飞行器在复杂的太空环境运行发明了 PI 薄膜，应对太空高低温交替、耐辐照、耐原子氧等问题。公司多次参与我国航天项目，一直以来持续建设保障能力，致力于保障关键材料的安全。公司也在开展耐原子氧 PI 薄膜的研发，应对低轨卫星及飞行器耐受原子氧冲击的能力，以提升卫星及飞行器使用寿命。但受制于航天领域总体用量有限，相关产品占公司营收份额较小，多为项目合作研发。

我国千帆计划及 GW 星网运行轨道基本在低轨，需要解决原子氧、辐照、紫外对卫星寿命造成的不利影响，目前公司有一款 CPI 薄膜正在搭载空间评价，截至目前反馈良好。因为空间功能性 PI 薄膜的价格不能用普通 PI 薄膜衡量，市场规模需伴随发行计划同步展开。公司将紧盯市场发展最新情况，预先做好技术研发储备，积极响应市场需求，抓住市场窗口带来的新机遇。